

锦州神工半导体股份有限公司

2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：万元 币别：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	44,277.20	30,272.95	46.26
营业利润	12,448.98	5,242.12	137.48
利润总额	12,433.96	5,252.76	136.71
归属于上市公司股东的净利润	10,145.47	4,115.07	146.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,977.64	3,834.34	160.22
基本每股收益（元）	0.60	0.24	150.00
加权平均净资产收益率	5.52	2.32	增加 3.20 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	208,044.04	199,290.33	4.39
归属于上市公司股东的所有者权益	188,676.77	179,296.15	5.23

股本	17,030.57	17,030.57	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	11.08	10.53	5.23

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。数据若有尾数差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025 年公司实现营业总收入 44,277.20 万元，同比增长 46.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,145.47 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,977.64 万元。

报告期末，公司总资产 208,044.04 万元，同比增长 4.39%；归属于上市公司股东的所有者权益 188,676.77 万元，同比增长 5.23%；归属于上市公司股东的每股净资产 11.08 元，同比增长 5.23%。

报告期内，全球半导体市场持续回暖，带动公司营业收入稳步增长。公司产能利用率提升，规模效应显现，叠加内部管理优化，公司盈利能力稳步上行。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的变动说明

公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益指标较上年同期相比增长均超过 30%，主要系：

1、报告期内，全球半导体市场持续回暖，其中，海外市场受到人工智能需求拉动，高端逻辑、存储芯片制造厂开工率持续提升，资本开支有所增加，带动公司大直径硅材料业务收入稳步增长；中国本土市场国产替代加速，资本开支持续增长，特别是存储芯片制造厂在技术和产能两方面紧跟全球先进水平，对关键耗材需求增加，带动公司硅零部件业务收入快速增长。

2、公司紧抓下游市场回暖机遇，通过生产组织优化、工序效率提升，实现产能利用率与产销规模稳步提高，规模效应逐步释放；同时持续推进降本增效、内控精细化管理，进一步巩固并提升盈利水平。

三、风险提示

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审

计，具体数据以公司2025年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年2月26日